

***Judul:***

Pengembangan material solder bebas timbal berbasis Sn-0,7Cu-xZn = The development of lead free solder material Sn-0,7Cu-xZn

***Pengarang/Penulis:***

Siahaan, Erwin, author

***Subjek:***

Solder and soldering; Lead-free electronics manufacturing processes

***Nomor Panggil:***

D2002

***Penerbitan:***

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)